

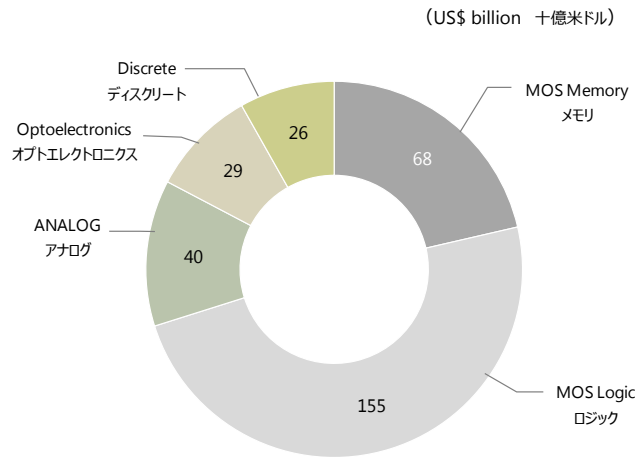
INVESTORS GUIDE



Year Ended of March 31, 2014
2014年3月期

Market Data 市場データ	1
Business Segments 事業セグメント	2
Consolidated Financial Results, Geographic Sales, Number of Employees 連結経営成績、地域別売上高、従業員数	3
Operating Results by Business Segment 事業別セグメントの状況	4
Profitability, R&D Expenses, Capital Expenditures, Depreciation and Amortization 収益性、研究開発費、設備投資額、減価償却費	5
Financial Position, Cash Flow Condition 連結財政状態、連結キャッシュ・フローの状況	6
Share Information 株式情報	7

Semiconductor Market by Category in 2013
2013年半導体品種別売上高



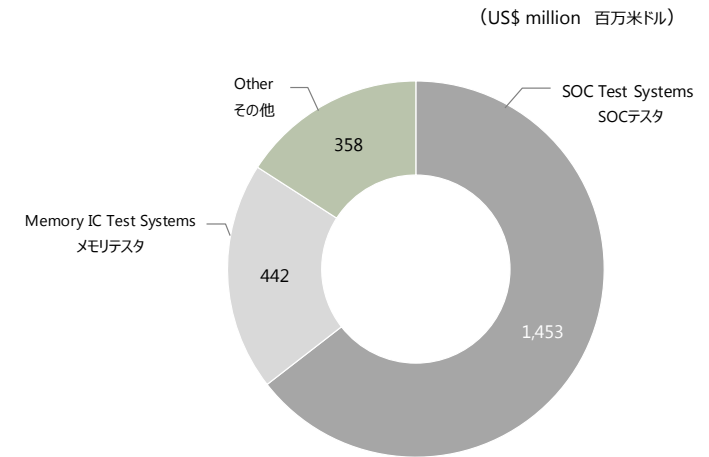
Source: VLSI Research, April 2014

Worldwide IC Manufacturing Equipment Sales Top 10
世界半導体製造装置メーカー売上上位10社

COMPANY	2013
Applied Materials	6,955
ASML	6,729
Tokyo Electron 東京エレクトロン	4,165
Lam Research	3,909
KLA-Tencor	2,805
Dainippon Screen Mfg. 大日本スクリーン製造	1,533
ASM International	1,265
Advantest アドバンテスト	1,187
Teradyne	1,023
Hitachi High-Technologies 日立ハイテクノロジーズ	1,007

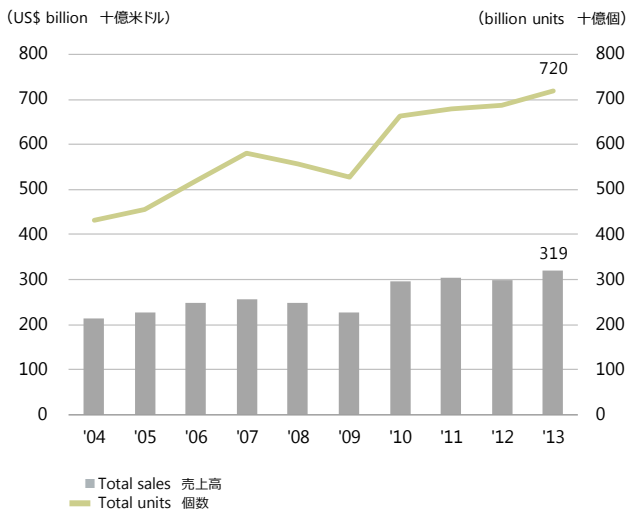
Source: VLSI Research, April 2014

Breakdown of IC Automated Test Equipment Market in 2013
2013年の半導体試験装置市場



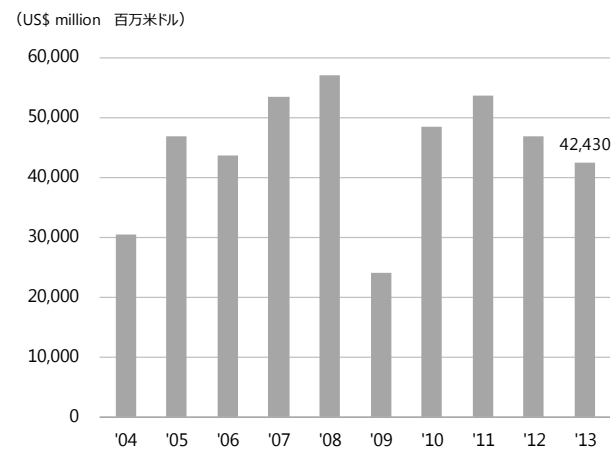
Source: VLSI Research, April 2014

Trend of Worldwide Semiconductor Market
半導体市場の推移



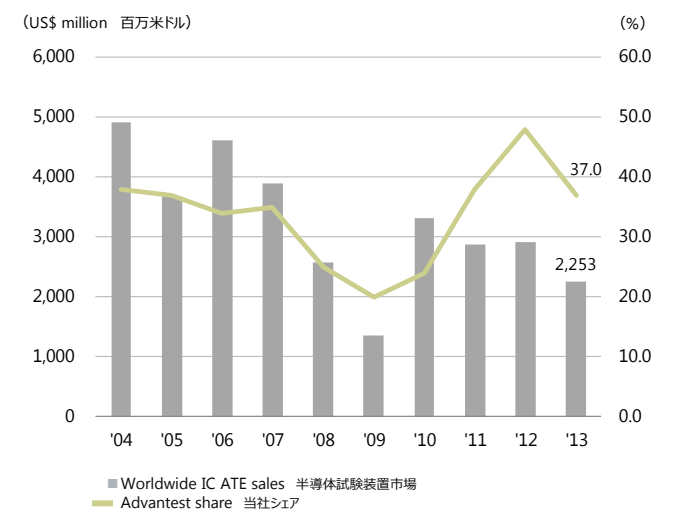
Source: VLSI Research, April 2014

Trend of IC and Related Equipment Market
半導体製造装置市場の推移



Source: VLSI Research, April 2014

Trend of IC Automated Test Equipment Market
半導体試験装置市場の推移



Source: VLSI Research, April 2014

Semiconductor and Component Test System

半導体・部品テストシステム事業

Semiconductor test systems, known as Automatic Test Equipment (ATE), are essential to quality assurance. Advantest is a pioneer in this field and a world leader in test technology. Our diverse, high-productivity solutions provide unmatched support for suppliers of various devices, ranging from logic ICs to the memory chips used in computers, servers, game consoles, smartphones and vehicles.

半導体試験装置（ATE）は、半導体デバイスが正しく動作するか、良否判定を行うための装置です。業界随一の技術力により、世界トップクラスの市場シェアを占める当社の主力事業です。パソコン、ゲーム機、スマートフォン、自動車などに使われる、ロジックICやメモリICをはじめとしたさまざまな半導体の品質を、高い生産性と多彩なソリューションで支えます。

Memory Test System

メモリ半導体用テストシステム



T5503HS

Non Memory Test System

非メモリ半導体用テストシステム



V93000

T2000

Services, Support and Others

サービス他

Advantest provides prompt, customer-optimized solutions for issues ranging from test system installation and productivity improvement through to maintenance and test program development. Additionally, we continue to develop groundbreaking products such as terahertz spectroscopic / imaging systems, SSD protocol testers and mobile handset system test solutions, targeting diverse new markets. Earnings from these new businesses are also included in this segment.

半導体試験装置や電子計測器の設置、生産性向上、メンテナンス、テスト・プログラムの開発など、テスト・計測に関わる課題に対する最適なソリューションをスピーディーにお届けしています。またテラヘルツ分光・イメージング解析システムやSSDプロトコル・テスト、モバイル機器のシステム・レベル・テスト用ソリューションなどの画期的な製品で、新たな事業の育成にも挑戦しています。



TAS7500
Terahertz Spectroscopic /
Imaging System
テラヘルツ分光・イメージング・システム

Mechatronics System

メカトロニクス関連事業

Factory Automation FA製品

Test handlers transfer packaged semiconductors in large batches to a test system, then grade them, identifying faulty devices. Featuring highly accurate placement technology and high-throughput thermal control, Advantest's test handlers maximize production efficiency for device manufacturers.

テスト・ハンドラは、パッケージされた半導体を多数個同時に半導体試験装置に搬送し、判定結果に従って分別する装置です。当社の高精度の搬送位置決め技術と高スループットで高度な温度印加技術により、精細化が進む先端デバイスの量産効率を最大化します。



M4871
SoC Test Handler
SoCテスト・ハンドラ

Device Interfaces DI製品

DI products are electrical and mechanical units that connect semiconductor devices to test systems. They include probe cards, load boards, Hifix, and change kits. Advantest's high-quality data transfer technology, and our worldwide network of design and production facilities, enable our DI products to contribute significantly to reducing customers' time-to-market.

デバイス・インタフェースは、半導体デバイスを半導体試験装置に接続するために必要な、プローブ・カード、Hifix、チェンジ・キットなどのユニットの総称です。電気信号を高品質に伝送する技術と、世界を網羅した設計・生産ネットワークで、お客様の設計・製造リードタイム短縮に貢献します。

Nanotechnology ナノテクノロジー製品

Advantest offers two product families of cutting-edge semiconductor manufacturing solutions utilizing the electron beam (EB) control technologies we have amassed through our R&D activities. Our EB lithography systems write 1x nanometer node circuit patterns onto semiconductor wafers and other substrates, while our metrology / review systems enable real-time measurement and defect review of pattern width, height, and side wall angles.

アドバンテストが培ってきた電子ビーム制御技術を活用し、最先端の半導体製造・プロセス開発に貢献する製品です。半導体ウエハなどに微細な回路パターンを描画する電子ビーム露光装置と、描画された回路パターンの幅、高さ、側壁角度を3次元でリアルタイム計測 / 欠陥レビューできる測長システムを提供しています。



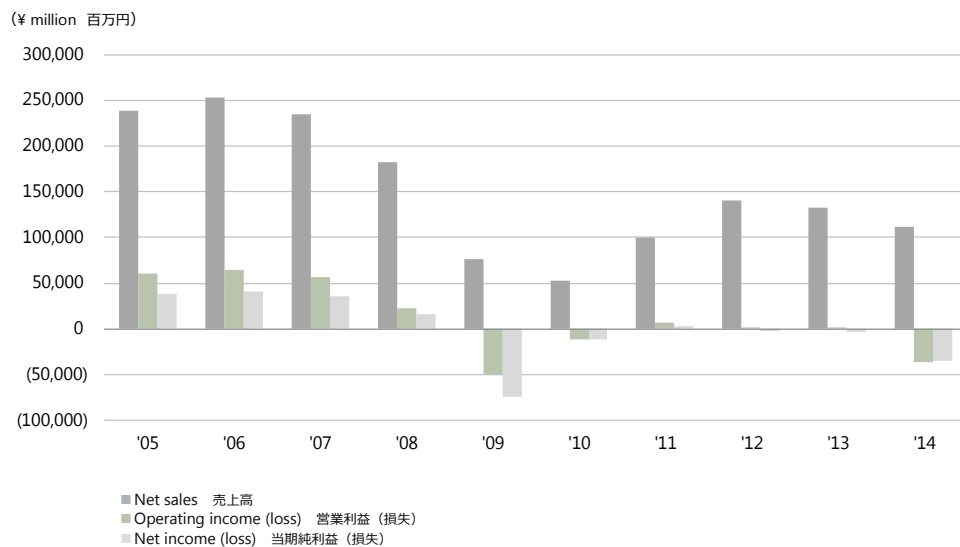
F7000
E-Beam Lithography System
電子ビーム露光装置



E3640
Mask MVM-SEM
マスクMVM-SEM

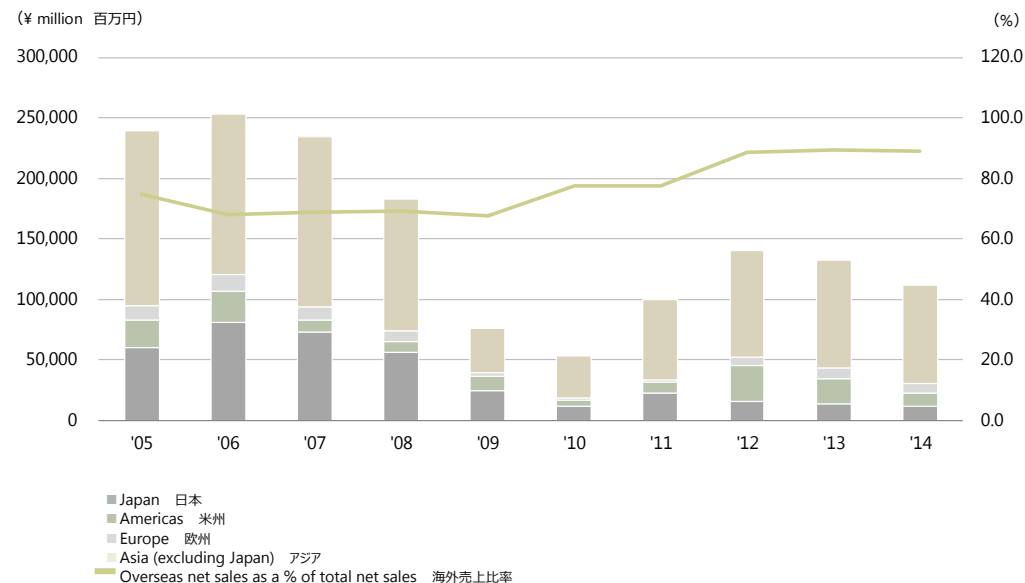
Consolidated Financial Results

連結経営成績



Geographic Sales

地域別売上高



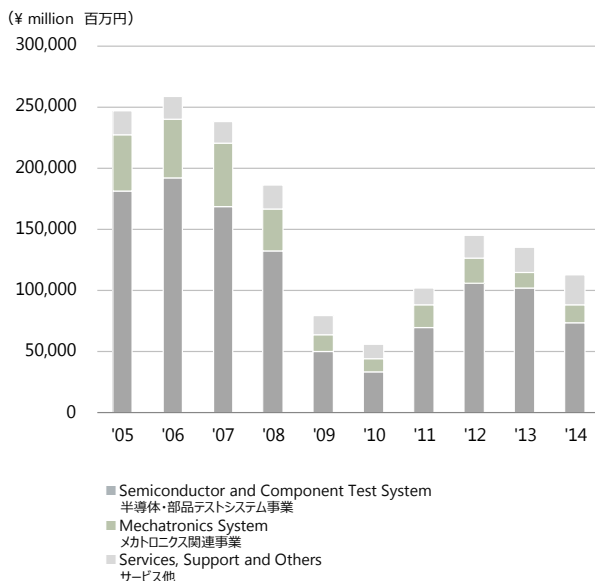
Years ended March 31 (U.S. GAAP)	3月31日に終了した1年間	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Consolidated financial results											
Net sales	売上高	239,439	253,922	235,012	182,767	76,652	53,225	99,634	141,048	132,903	111,878
Gross profit	売上総利益	123,445	132,493	126,294	93,930	19,815	25,928	48,470	68,748	68,920	49,333
Operating income (loss)	営業利益 (損失)	60,719	64,458	56,792	22,716	(49,457)	(11,639)	6,111	837	80	(36,369)
Income (loss) before income taxes and equity in earnings (loss) of affiliated company	税引前当期純利益 (損失)	61,808	67,454	61,090	23,533	(52,761)	(9,926)	5,551	(3,442)	(1,293)	(35,501)
Net income (loss)	当期純利益 (損失)	38,078	41,374	35,556	16,550	(74,902)	(11,454)	3,163	(2,195)	(3,821)	(35,540)
Geographic sales*											
Japan	日本	60,025	81,140	72,834	56,032	24,734	11,976	22,398	16,095	14,045	12,221
Americas	米州	23,024	25,516	10,158	9,616	11,759	4,930	9,278	29,742	20,583	10,720
Europe	欧州	12,270	14,558	11,238	8,859	2,844	2,137	2,252	7,015	9,061	7,276
Asia (excluding Japan)	アジア	144,120	132,708	140,782	108,260	37,315	34,182	65,706	88,196	89,214	81,661
Overseas net sales as a % of total net sales	海外売上比率	74.9%	68.0%	69.0%	69.3%	67.7%	77.5%	77.5%	88.6%	89.4%	89.1%
Number of employees											
Number of employees	従業員数 (人)	3,565	3,595	3,637	3,666	3,187	3,151	3,163	4,464	4,575	4,625
Average temporary employees	(外、平均臨時雇用者数)	447	505	641	909	565	217	223	279	330	278

*Note: Geographic sales are based on the location to which the products shipped.

※注：地域別売上高は、出荷先の所在地に基づいています。

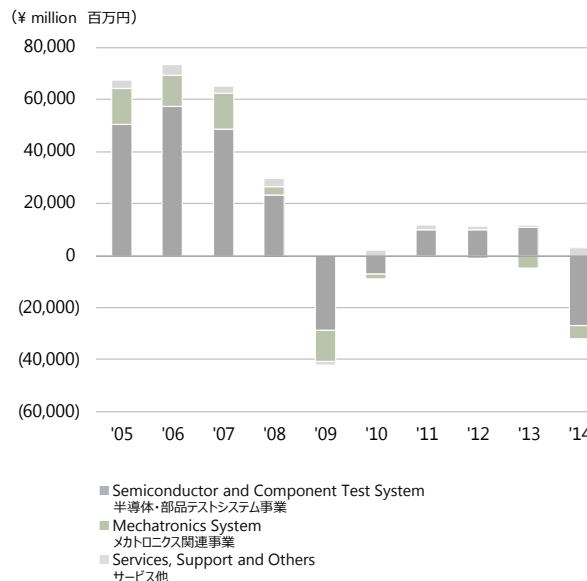
Net sales by Business Segment

事業セグメント別売上高



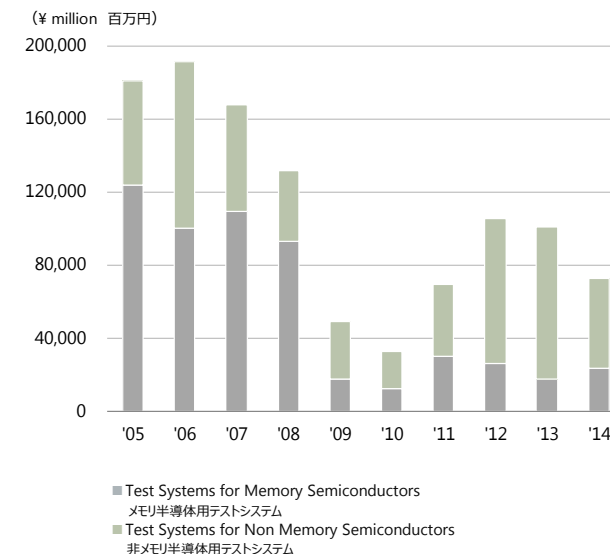
Operating Income (Loss) by Business Segment

事業セグメント別営業利益 (損失)



Net Sales Breakdown of Semiconductor and Component Test System Segment

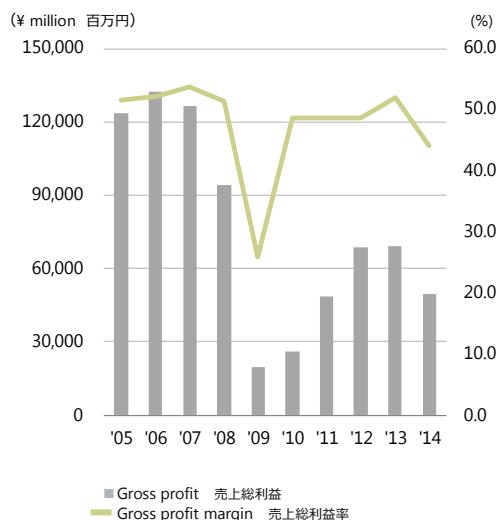
半導体・部品テストシステム事業売上高内訳



Years ended March 31 (U.S. GAAP)	3月31日に終了した1年間	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Net sales by business segment	事業セグメント別売上高										
Semiconductor and Component Test System	半導体・部品テストシステム事業	180,685	191,415	167,815	131,608	49,216	32,572	69,333	105,608	101,119	73,017
Mechatronics System	メカトロニクス関連事業	46,395	48,260	52,025	34,944	14,388	11,237	18,515	20,616	13,653	14,984
Services, Support and Others	サービス他	19,680	19,062	18,312	19,344	15,815	11,838	14,166	18,807	20,077	24,151
Elimination and corporate	消去または全社	(7,321)	(4,815)	(3,140)	(3,129)	(2,767)	(2,422)	(2,380)	(3,983)	(1,946)	(274)
Operating income (loss) by business segment	事業セグメント別営業利益 (損失)										
Semiconductor and Component Test System	半導体・部品テストシステム事業	50,624	57,517	48,608	23,263	(28,914)	(7,042)	9,857	9,845	10,956	(26,724)
Mechatronics System	メカトロニクス関連事業	13,662	11,966	13,647	3,266	(11,865)	(1,897)	(251)	(1,324)	(4,614)	(5,063)
Services, Support and Others	サービス他	3,402	3,853	2,870	3,177	(1,099)	2,175	2,133	1,614	775	3,012
Elimination and corporate	消去または全社	(7,996)	(6,994)	(5,767)	(6,132)	(7,331)	(4,732)	(5,463)	(8,715)	(6,176)	(6,311)
Net sales breakdown of Semiconductor and Component Test System Segment	半導体・部品テストシステム事業売上高内訳										
Test Systems for Memory Semiconductors	メモリ半導体用テストシステム	123,856	100,311	109,541	92,896	17,644	12,444	30,016	25,913	17,751	23,403
Test Systems for Non Memory Semiconductors	非メモリ半導体用テストシステム	56,829	91,104	58,274	38,712	31,572	20,128	39,317	79,695	83,368	49,614
Total	合計	180,685	191,415	167,815	131,608	49,216	32,572	69,333	105,608	101,119	73,017

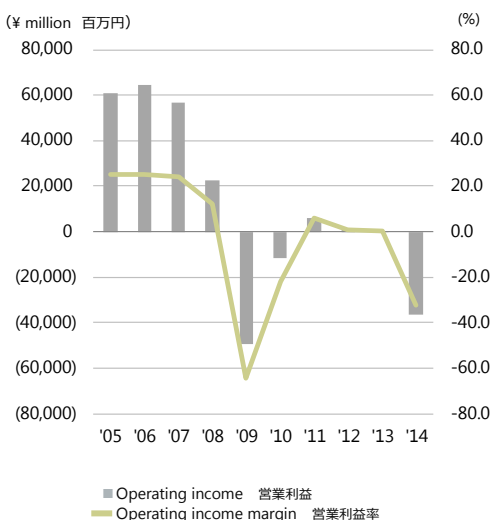
Gross Profit Margin

売上総利益率



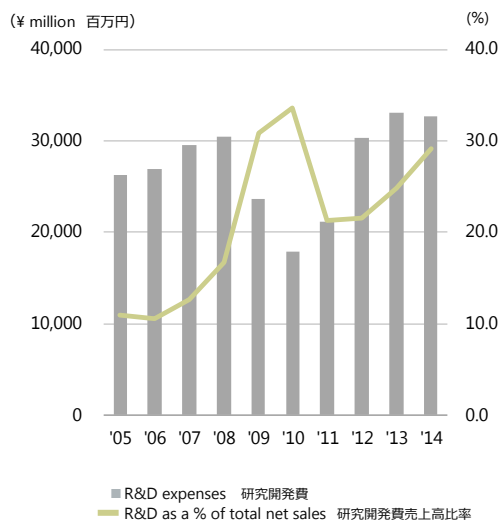
Operating Income Margin

営業利益率



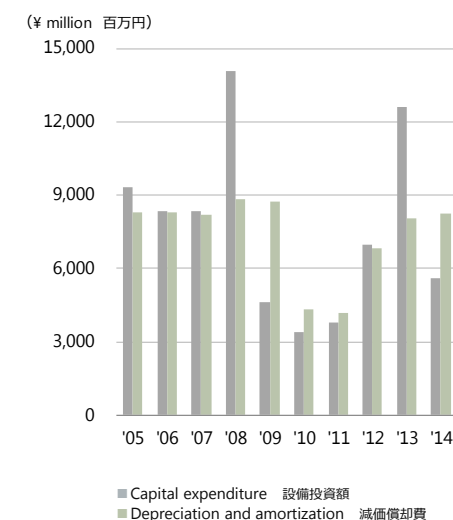
R&D Expenses

研究開発費



Capital Expenditures, Depreciation and Amortization

設備投資額、減価償却費



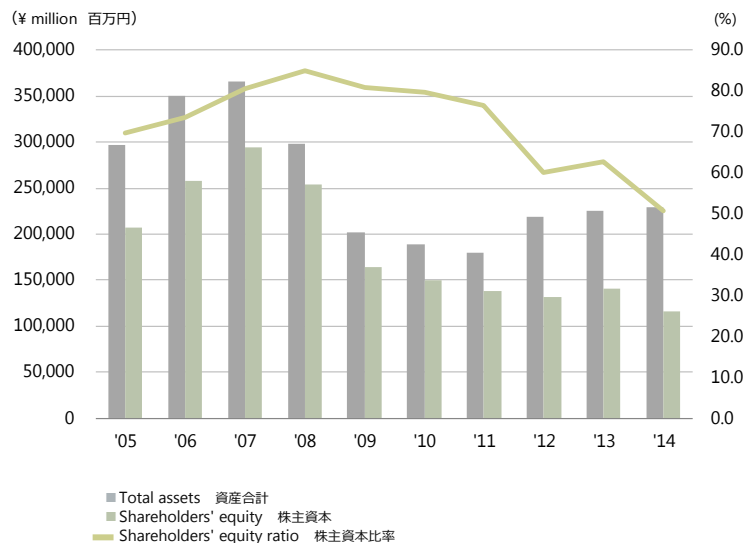
Years ended March 31 (U.S. GAAP)	3月31日に終了した1年間	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Profitability											
Net sales	売上高	239,439	253,922	235,012	182,767	76,652	53,225	99,634	141,048	132,903	111,878
Cost of sales	売上原価	115,994	121,429	108,718	88,837	56,837	27,297	51,164	72,300	63,983	62,545
Gross profit	売上総利益	123,445	132,493	126,294	93,930	19,815	25,928	48,470	68,748	68,920	49,333
Gross profit margin	売上総利益率	51.6%	52.2%	53.7%	51.4%	25.9%	48.7%	48.6%	48.7%	51.9%	44.1%
Operating expenses*	営業費用 (※注)	62,726	68,035	69,502	71,214	69,272	37,567	42,359	67,911	68,840	85,702
Operating income (loss)	営業利益 (損失)	60,719	64,458	56,792	22,716	(49,457)	(11,639)	6,111	837	80	(36,369)
Operating income margin	営業利益率	25.0%	25.4%	24.2%	12.4%	-64.5%	-21.9%	6.1%	0.6%	0.1%	-32.5%
Research and development expenses											
Research and development expenses	研究開発費	26,280	26,927	29,509	30,507	23,713	17,896	21,197	30,303	33,062	32,670
R&D as a % of total net sales	研究開発費売上高比率	11.0%	10.6%	12.6%	16.7%	30.9%	33.6%	21.3%	21.5%	24.9%	29.2%
Capital expenditures, Depreciation and amortization											
Capital expenditures	設備投資額	9,348	8,323	8,336	14,083	4,608	3,425	3,793	6,984	12,592	5,626
Depreciation and amortization	減価償却費	8,285	8,275	8,214	8,836	8,719	4,314	4,209	6,838	8,063	8,268

*Note: Operating expenses are composed of research and development expenses, selling, general and administrative expenses. Figures for the fiscal year ended March 31st, 2009, also include restructuring and impairment charges; figures for the fiscal year ended March 31st, 2014, also include impairment charges.

※注：上記の営業費用は、研究開発費、販売費および一般管理費の合計です。なお、2009年3月期の値には構造改革費用および減損費用を、2014年3月期の値には減損費用を含みます。

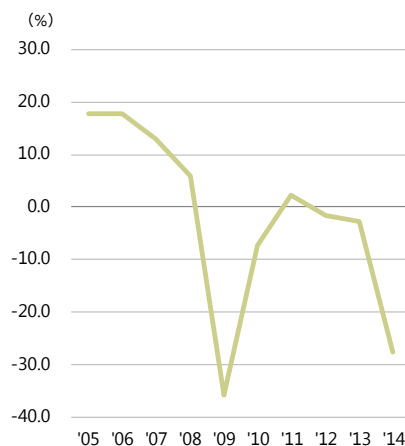
Shareholders' Equity Ratio

株主資本比率



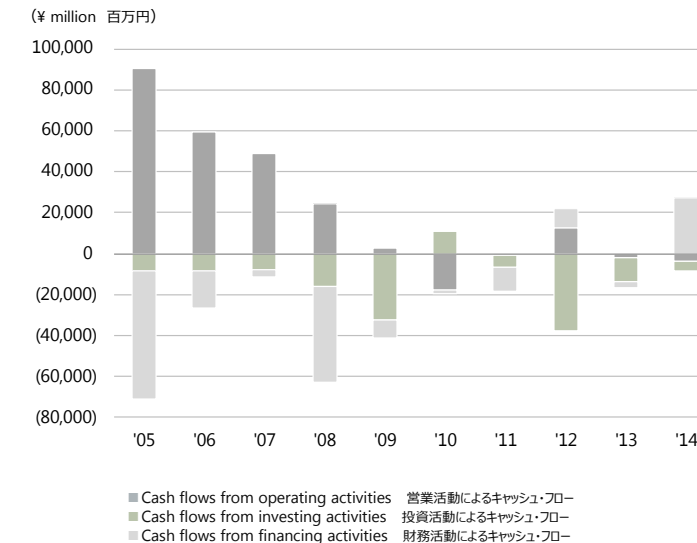
ROE

株主資本利益率



Cash Flows

連結キャッシュ・フロー



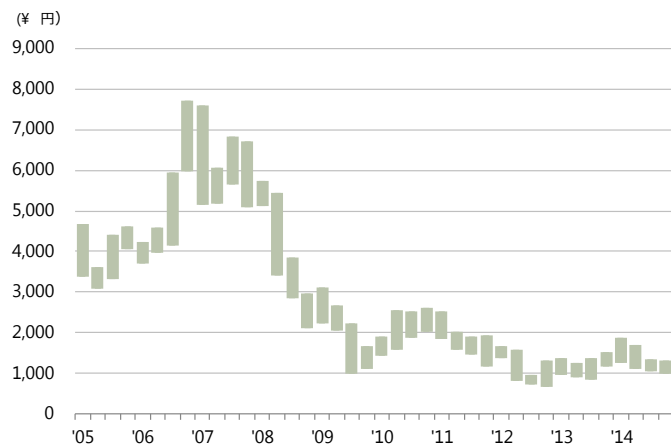
Years ended March 31 (U.S. GAAP)	3月31日に終了した1年間	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Financial position		(¥ million 百万円)									
連結財政状態											
Total assets	資産合計	296,769	350,776	366,374	298,684	202,059	188,663	180,312	219,226	225,515	229,856
Shareholders' equity	株主資本	206,749	257,927	294,797	254,184	163,616	150,242	138,132	131,552	141,241	116,252
Shareholders' equity ratio	株主資本比率	69.7%	73.5%	80.5%	85.1%	81.0%	79.6%	76.6%	60.0%	62.6%	50.6%
ROE	株主資本利益率 (ROE)	17.8%	17.8%	12.9%	6.0%	-35.9%	-7.3%	2.2%	-1.6%	-2.8%	-27.6%
Cash flow condition											
連結キャッシュ・フローの状況											
Cash flows from operating activities	営業活動によるキャッシュ・フロー	90,327	59,480	48,951	24,166	2,357	(17,746)	(693)	12,302	(2,215)	(3,776)
Cash flows from investing activities	投資活動によるキャッシュ・フロー	(8,250)	(8,542)	(8,013)	(16,322)	(32,507)	10,824	(5,828)	(37,670)	(11,498)	(4,711)
Cash flows from financing activities	財務活動によるキャッシュ・フロー	(63,036)	(18,336)	(3,662)	(46,770)	(8,930)	(1,803)	(12,028)	9,887	(2,914)	27,202
Free cash flows	フリー・キャッシュ・フロー	82,077	50,938	40,938	7,844	(30,150)	(6,922)	(6,521)	(25,368)	(13,713)	(8,487)
Cash and cash equivalents at end of year	現金および現金同等物の期末残高	120,986	157,925	196,395	147,348	105,455	96,439	75,323	58,218	45,668	68,997

ROE = Net income / Average shareholders' equity 株主資本利益率 = 当期純利益 ÷ 株主資本 (期中平均)

Free cash flows = Cash flows from operating activities + Cash flows from investing activities フリー・キャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー

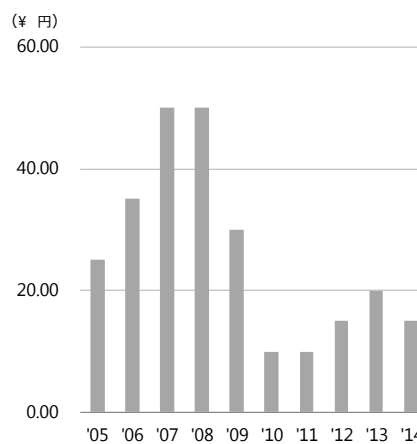
Quarterly Share Price Range

株価の推移



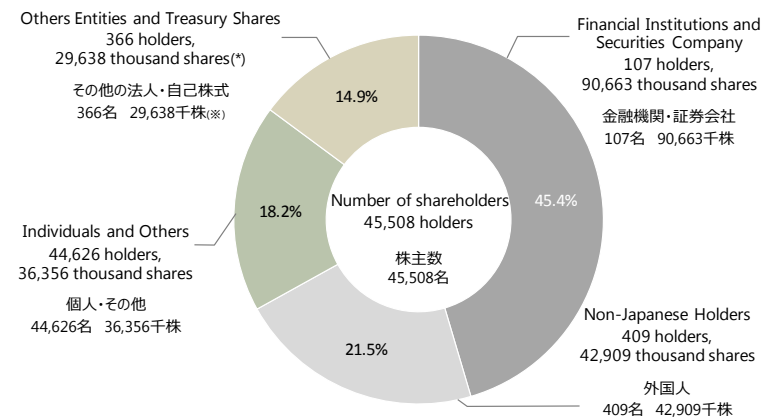
Dividend per Share

1株当たり配当金



Breakdown of Shareholders

所有者別株式数分布状況



(*) 25,368,828 shares of treasury shares listed under "Other Entities and Treasury Shares."
 (※) 自己株式25,368,828株は「その他の法人・自己株式」に含めて記載しています。

Years ended March 31	各3月31日までの1年間	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Quarterly share price range	株価の推移 (四半期ベース)										
1Q	High (¥)	4,665	4,235	7,605	5,750	3,100	1,910	2,516	1,663	1,386	1,887
	Low (¥)	3,370	3,700	5,160	5,120	2,235	1,423	1,860	1,387	952	1,246
2Q	High (¥)	3,630	4,580	6,065	5,450	2,660	2,550	2,020	1,591	1,261	1,710
	Low (¥)	3,090	3,955	5,185	3,410	2,050	1,581	1,571	802	914	1,121
3Q	High (¥)	4,405	5,945	6,820	3,850	2,240	2,525	1,916	970	1,374	1,343
	Low (¥)	3,315	4,140	5,640	2,855	996	1,864	1,456	718	838	1,061
4Q	High (¥)	4,625	7,715	6,720	2,975	1,666	2,615	1,924	1,323	1,525	1,315
	Low (¥)	4,050	5,965	5,100	2,100	1,122	2,033	1,179	671	1,156	988
Years ended March 31	3月31日に終了した1年間	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Number of shares issued	発行済株式数の推移										
Number of shares issued at year-end	発行済株式数 (期末)	199,566,700	199,566,700	199,566,770	199,566,770	199,566,770	199,566,770	199,566,770	199,566,770	199,566,770	199,566,770
Investment indicator	投資指標										
Net income (loss) per share-Basic (¥)	1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 (円)	194.77	223.17	190.01	90.72	(419.09)	(64.09)	18.03	(12.67)	(22.03)	(204.10)
Shareholders' equity per share (¥)	1株当たり株主資本 (円)	1,118.49	1,381.85	1,570.99	1,422.20	915.47	840.65	797.20	759.22	812.70	667.36
Dividend per share (¥)	1株当たり配当金 (円)	25.00	35.00	50.00	50.00	30.00	10.00	10.00	15.00	20.00	15.00
Dividend payout ratio	配当性向	12.8%	15.7%	26.3%	55.1%	-	-	55.5%	-	-	-

Note: On Oct. 1, 2006, a one to two stocks split was made to share of common stock. Prior to March 31, 2007, all share and per share information has been adjusted to reflect the stock split.

注：2006年10月1日に、当社は普通株式1株につき2株の割合で株式分割しました。それ以前の各期の株価情報と1株当たり指標は、それぞれの期首にこの株式分割が行われたと仮定して算出しています。